

歯科接着用レジンセメント

Tokuyama Dental

エステセム II

オートミックス セット

2022年
4/21(木) ▶ 6/20(月)

ミキシングチップ セメント用 増量 キャンペーン

2022年4月1日より

臼歯部CAD/CAMインレーの保険診療に

「エステライトブロックII」

「エステライトPブロック」を

お使いいただけます。

CAD/CAMインレーの接着にも

エステセムIIを

是非ご使用ください。



ミキシングチップ セメント用

20個 増量 (¥2,000相当)



歯科接着用レジンセメント

エステセム II

オートミックス セット

標準医院価格 **¥19,800** / セット

エステセム II 歯科接着用レジンセメント (管理医療機器) 認証番号228AFBZX00129000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2022年4月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

エステセムII オートミックスセット ミキシングチップ セメント用 増量キャンペーン 注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL ()

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、
ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

エステセムII オートミックスセット
チップ増量キャンペーン

[キャンペーンコード: 16127]

セット

お届け歯科商店名

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)

株式会社 トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌TEL011-812-5690 ●仙台TEL022-717-6444 ●東京TEL03-3835-7201 ●名古屋TEL052-932-6851 ●大阪TEL06-6386-0700 ●福岡TEL092-412-3240

エステセムⅡは、素材によって塗り分ける必要がない 「ボンドマー ライトレス」を 前処理材とした接着性レジンセメント。



- **CAD/CAM冠およびインレー**（ハイブリッドレジン）、**メタルセラミックス**、**メタル**、**オールセラミックス**等、様々な修復物に高接着。
- ペーストは垂れにくく、**余剰セメントは除去しやすい**。



簡単に取れる

焦ることがない（除去）余裕時間

操作性向上の大きなポイント
余剰セメントの除去

例えば、光照射2秒で（800mW/cm²の場合）、
2分半の間、半硬化状態が続きます。

ロングスパンブリッジ、多数歯でも、余剰セメント除去に余裕があります。

光照射による半硬化後の除去可能時間（目安）

37℃湿潤雰囲気下

		0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4 (分)
照射強度 800mW/cm ²	照射 2 秒								
	照射 4 秒								
化学硬化									

■ 除去可能時間

- 照射強度が強くなると除去可能時間は短くなる傾向。
- 照射距離が長くなると除去可能時間は長くなる傾向。
- 1,000mW/cm²の光照射で、照射面から3mm離れると、約800mW/cm²の光の強さ。

メモ：CASE REPORT No.15 遠山先生の症例写真より抜粋しています。

- **マージン部での着色・変色、摩耗が少ない。**

耐着色性

耐変色性

CAD/CAM冠(エスライトブロックⅡ)に「エステセムⅡ」(オートミックス)を使用した場合の操作手順

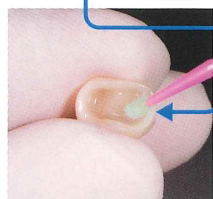
ボンドマー ライトレス



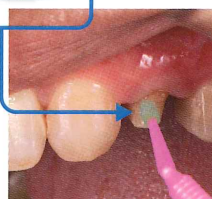
補綴物の被着面処理



30-50μmアルミナで10秒以内のサンドブラスト処理(0.1～0.2MPa)した後、水洗・乾燥



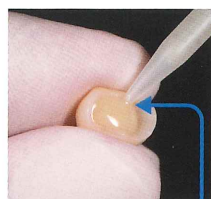
試適・清掃後、ボンドマー ライトレスA液・B液を等量混和、塗布後すぐに中圧のエアーで十分に乾燥



支台歯もボンドマー ライトレスを塗布。弱めのエアーでボンド層が動かないまで乾燥。その後中圧～強圧で十分に乾燥

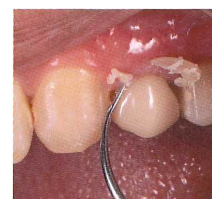
レジンコア、メタルコアの場合も、「ボンドマー ライトレス」で処理

歯面処理



補綴物に「エステセムⅡ」ペースト塗布・装着後圧接

ペースト塗布・接着



2～4秒光照射、または1分から3分半以内で、半硬化の状態の余剰セメントをおおまかに除去



20秒以上最終光照射
※写真の都合上、照射器先端は離れていますが、実際は補綴物に近づけて光照射を行ってください



エステセムⅡ